

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-084

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过孙公司投资建设年产 20000 吨

高速通信基板用电子材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资项目名称：

年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

● 投资金额：人民币70,000万元

● 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

● 本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

在“1+3”发展战略的引领下，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有技术储备和创新技术平台为依托，在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司，自主研发出马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂、碳氢树脂、低介质损耗热固性聚苯醚树脂等电子级树脂材料，并于 2021 年投资建设“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”。该项目的主要产品

马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂性能优异、质量稳定、竞争优势明显、市场拓展顺利，并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系，占据了较高的市场份额。

为进一步扩大产能规模和领先优势，丰富产品结构，积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用，公司拟通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司（以下简称“眉山东材”）在四川省眉山市投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。

（二）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。董事会战略委员会认为：本次公司通过孙公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，旨在进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

本次投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

1、公司名称：东材电子材料（眉山）有限公司

2、注册资本：3亿元

3、法定代表人：庞少朋

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室

6、成立日期：待公司第六届董事会第十一次会议审议通过后，以办理工商登记手续的日期为准。

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能复合材料制造；电工器材销售；高性能复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

项目实施主体的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、投资项目的具体情况

项目名称：年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

项目建设地址：四川省眉山市高新技术产业园区

项目建设内容：新建生产车间、中试车间、危化品库、产品库、危废库、废水处理设施、废气处理RTO设施、导热油锅炉、办公楼以及消防安全设施等。

建成后，将形成年产20000吨高速通信基板用电子材料产品生产能力（其中：5,000吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、2,000吨电子级非结晶型马来酰亚胺树脂、1,500吨电子级结晶型马来酰亚胺树脂、4,000吨电子级低介质损耗活性酯固化剂树脂、3,500吨电子级碳氢树脂、4,000吨电子级低介质损耗含磷阻燃树脂）。

项目投资规划：项目总投资70,000万元，其中：固定资产投资66,000万元，铺底流动资金4,000万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成试生产投产预计为24个月，自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产高速通信基板用电子材料，主要包括电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、电子级非结晶型马来酰亚胺树脂、电子级结晶型马来酰亚胺树脂、电子级低介质损耗活性酯固化剂树脂、电子级碳氢树脂、电子级低介质损耗含磷阻燃树脂。

四、投资项目的必要性

近年来，随着数字化基础设施建设不断完善，商业化应用加速落地，人工智能已成为助推科技高质量发展、赋能千行百业的重要推手，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速传输的需求不断攀升；与此同时，伴随卫星通信技术的发展和商业航天成本的不断降低，低轨卫星的发射组网逐渐成熟，对通讯基板的工作频段、传输速率、工作负载提出更高的性能需求。作为其硬件载体，高性能覆铜板的市场需求保持高速增长。

从产业链格局来看，随着海外覆铜板及下游PCB产能纷纷向我国转移，国内厂商密集投放产能，我国基础覆铜板行业的产能规模迅速扩大，占全球产能70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是，我国的产能结构分化严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争激烈，而高性能覆铜板（HDI板、IC载板等）领域的技术壁垒较高，前沿技术尚未攻克，贸易逆差仍在持续攀升。为避免受到国际金融博弈和原材料价格的牵制，国内覆铜板企业正加快中高端领域的产能投放，积极寻找国内电子级树脂供应商，联合开发高频、高速等高性能覆铜板的多元化解决方案，从而为上游电子材料实现进口替代带来了广阔的市场空间。

五、项目预计收益

本项目建成实现满产后，预计平均每年可实现年销售收入约200,000万元，实现年利润总额约60,000万元。本项目所得税后的投资内部收益率预计为40.00%，所得税后投资回收期预计为4.8年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、本次投资对上市公司的影响

本次公司通过孙公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，将有力促进电子材料的国产化进程，进一步增强我国高性能覆铜板产业链的配套能力，助推我国人工智能、低轨卫星产业的高速发展，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，积极拓展新兴应用领域，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

本项目定位于生产高速通信基板用电子材料，下游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

七、本次投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

（三）化工产业化项目在报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的审批部门和程序较多，项目存在因项目审批进度未达预期，导致项目建设进度延期的风险。

对此，公司将加强与相关政府部门的沟通积极推进项目建设，积极关注经济形势的变化，密切跟踪下游市场需求，通过加大研发投入、不断提升产品技术水平、改善营销模式等方式，持续降低企业经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日